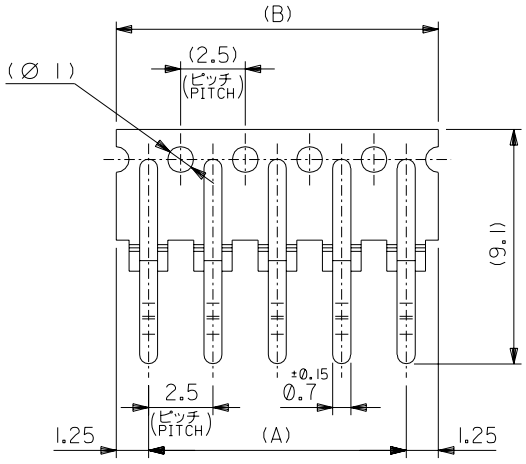
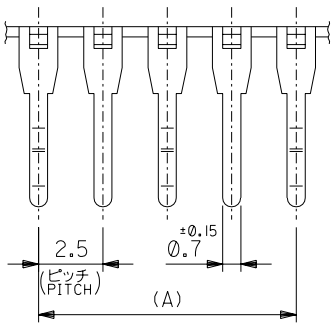
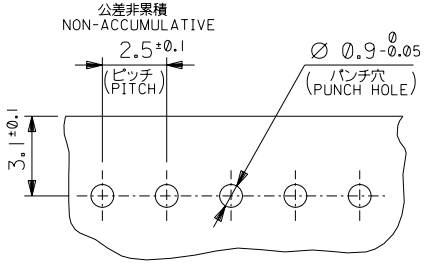
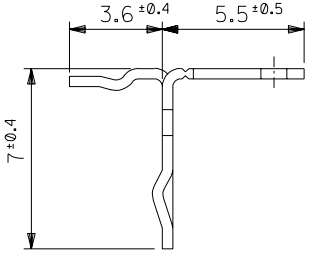
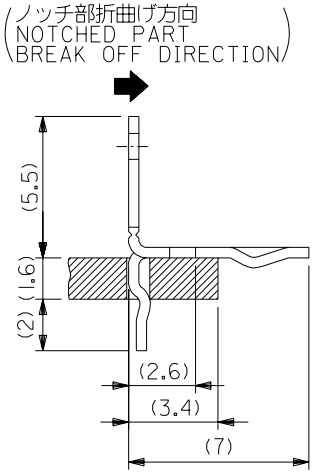


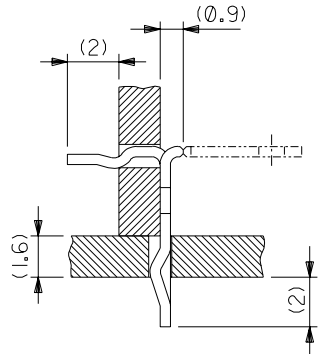




基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIMENSION







注記
NOTES

1. ソルダーテールのキンク加工 SOLDER TAIL KINK ： 短いテール側は全てのピンに同一方向に施す。
長いテール側は1ピンおきに同一方向に施し、
且つ、奇数極の場合は両端にキンクがあること。
FOR SHORT TAILS : SET KINK TO ALL TAILS IN THE SAME DIRECTION.
FOR LONG TAILS : SET KINK TO EVERY OTHER TAIL IN THE SAME DIRECTION
AND THE TAILS ON BOTH ENDS IN CASE OF ODD CKT.

2. 基板の材質及び穴の断面形状により、基板装着性及び基板保持性に差があります。
また、少極品と多極品でも同様の事が言える為、この点を確認の上御使用願います。
THE MATERIAL AND THE HOLE SECTION FORM OF THE BOARD,
THERE MAY BE DIFFERENCES AMONG THE BOARD APPLICATION
AND THE BOARD RETENTION. ALSO, THE SAME COULD BE SAID
ON SMALL CIRCUIT PARTS AS WELL AS LARGE CIRCUIT PARTS.
PLEASE KEEP THIS IN MIND UPON USING THIS PART.

37.5	35	50055-8115	15
35	32.5	-8114	14
32.5	30	-8113	13
30	27.5	-8112	12
27.5	25	-8111	11
25	22.5	-8110	10
22.5	20	-8109	9
20	17.5	-8108	8
17.5	15	-8107	7
15	12.5	-8106	6
12.5	10	-8105	5
10	7.5	-8104	4
7.5	5	50055-8103	3
B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

無 鉛
LEAD FREE

角度 ANGLE	±3°					
30以上 OVER	±0.3					
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25	C	変更 REVISED (J2002-2847)	T.T / T.I	'02/05/17	
10未満 UNDER	±0.2	B	再作図 REDRAWN (J40020)	M.N / M.S	'94/1/12	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. / CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL リン青銅、錫メッキ材 PHOS.BRONZE (t=0.4) PRE-TINNED
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '94/1/12 M.NAKAMURA
CHK'D BY '02/05/17 T.ITO
APP'D BY '02/05/17 T.YAMAGUCHI
尺度 SCALE 5-1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.5 BOARD TO BOARD
SOLDER TERMINAL

DWG. NO. SD-50055-81** REV C

DWG. NO. SD-50055-81**

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

50055.S03

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。